



Muss jeder Sensor "smart" sein?

IMAPS Seminar, Donnerstag, 9. Februar 2006, Beginn: 9 Uhr

Veranstaltungsort: FH für Technik Esslingen Außenstelle Göppingen, Robert-Bosch-Str. 1

Thema	Vortragender, Firma, Ort der Firma
Podiumsvorträge	
Mikrosensoren für Kfz- Anwendungen	Roland Müller Fiedler, Bosch, Stuttgart
Warum folgt die Mechatronik dem Moore'schen Gesetz?	Kai Borgwarth, Micronas, Duisburg
3. Wie macht man einen Sensor smart?	Bedrich Hosticka, FHG IMS, Duisburg
4. Smarte Drucksensoren	Andreas Wülfing, WIKA, Klingenberg
Kaffeepause	
Podiumsdiskussion	Leitung: Ernst Schmidt, BMW, München Teilnehmer: Müller Fiedler, Borgwarth, Hostika, Wülfing
Mittagspause	
Fachvorträge	
iBolt TM -Technologie – Erweiterter Insassenschutz durch gewichtssensierende Airbag-Steuerung	Andreas Stratmann, Bosch, Reutlingen
2. Sensoren im Einsatz zur Ölzustandsüberwachung	Horst Mannebach, Hydac, Saarbrücken
3. Sensoren für mikro- und nanofluidische Systeme in biotechnischen Anwendungen	Andreas Schober, Thomas Friedrich, ZIK MacroNano, TU Ilmenau
Sensoren für die Medizintechnik unter Nutzung modularer optoelektronischer Komponenten	Arndt Steinke, CiS, Erfurt
Kaffeepause	
5. Werkstoff- und Technologiekonzepte für innovative Sensoranwendungen	Werner Schneider, MPD, Dresden
 Erfahrungen beim Einsatz von smarten künstlichen Nasen 	Olaf Kiesewetter, UST, Gschwenda
 Fadenspannungssensor in Dickschichttechnik 	Karl-Heinz Suphan, Microhybrid, Hermsdorf
8. Mikrosystem statt Komponenten – Systemintegration in der Sensorik	Johannes Herrnsdorf, HL Planartechnik, Dortmund
9. Sensoren in Dünnschichttechnik	Wolfgang Brode, Siegert TFT, Hermsdorf

Den Programmflyer mit Anmeldeformular für die Aussteller können Sie unter www.imaps.de herunterladen.



Gemeinsames PIDEA+ Eurimus II Meeting in Berlin

Von Mittwoch, den 30. November 2005 bis Freitag, den 2. Dezember 2005 fand das erste gemeinsam Treffen der beiden *Eureka-*Cluster statt. Gastgeber für das Treffen war der *VDI/VDE-IT*; *Helmut Kergel* führte durch die Veranstaltung. Von französischer Seite konnten mit *Pierre Roche* und *Remy Remaudin* zwei Vertreter des Industrieministeriums begrüßt werden, seitens des BMBF war kein Vertreter anwesend.

Hintergrund für die Durchführung einer gemeinsamen Veranstaltung ist die angestrebte Verschmelzung der beiden Cluster *Eurimus II* und *PIDEA*+.

Beschlossen wurde diese Vorgehensweise bereits auf der Sitztung der *Eureka High Level Group* im September in Prag, ein entsprechender Beschluss seitens *PIDEA*+ wurde durch die Generalversammlung Ende September im Rahmen der *Interconnex Grenoble* gefasst.

Ziel der Verschmelzung ist es, aus den beiden artverwandten Anliegen der Systemintegration und der Mikrosystemtechnik ein großes Cluster mit hohem Gewicht und einer großen kritischen Masse unter dem Schlüsselbegriff Smart System Integration zu schaffen.

Unter diesem Gesichtspunkt war das Treffen in eine Reihe paralleler und gemeinsamer Veranstaltungen gegliedert: Getrennt trafen sich am Mittwoch und Donnerstag-Vormittag die Technischen Komitees, das Council und die "Public Authorities" der Cluster, um die einzelnen Positionen abzustimmen und für eine Verschmelzung vorzubereiten

Am Nachmittag fand dann ein gemeinsames Treffen aller statt, in dem die erarbeiteten Ergebnisse dargestellt, besprochen und die weitere Vorgehensweise festgelegt wurde. Beendet wurde der Donnerstag mit einem Task Force Meeting aus Erfahrungsträgern beider Cluster, um die gemeinsamen inhaltlichen Positionen herauszuarbeiten.

Am Freitag erfolgte wiederum getrennt das gemeinsame Treffen der jeweiligen Ratsmitglieder mit den "Public Authorities", um den Status der zur Förderung empfohlenen und mit dem Label ausgezeichneten Projekte zu besprechen.

Höhepunkt der Veranstaltung war der gemeinsame Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen mit Focus *Smart System Integration*.

Vorschläge können bis **20. Januar** per Post oder e-mail an das *PIDEA Office* in Paris (*yves.legoff@pidea.com.fr*) eingereicht werden.

Neuer Vorsitzender des PIDEA+ Technical Advisory Committees

Franz Bechtold, langjähriges Ratsmitglied von PIDEA+ und seit 2003 Vorsitzender des PIDEA+ Technical Advi-

sory Committees, ist von dieser Position zurückgetreten. Neu gewählt wurde Ing. Dr. sc. techn. Klaus-Dieter Lang, seit vielen Jahren Erfahrungsträger im Bereich der Systemintegration in der Industrie und am Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration und seit 2004 Leiter der Abteilung Photonic and Power System Assembly.

Dr. Lang ist bereits in *Eurimus II*-Projekte involviert, kennt deren Organisation und ist von dieser Seite bestens vorbereitet, die notwendigen Aktivitäten zur Verschmelzung der beiden Cluster zu begleiten.

Noch zu haben: Proceedings

Die Proceedings des *Deutschen IMAPS-Seminars 2005*, das am 10. Februar 2005 in Göppingen zum Thema *Hochtemperaturelektronik* stattfand, können noch auf CD zum Preis von



€ 55,-

und als Papierausdruck zum Preis von



€ 110.-

erworben werden

Auch die Proceedings der *Herbsttagung 2005*, die am 10. und 11. Oktober 2005 in München durchgeführt wurde, sind als CD zum Preis von



€ 55,-

erhältlich.

Richten Sie bitte Ihre Bestellungen an:

Prof. Dr. Wolfgang Radlik, c/o FH Rosenheim, Hochschulstraße 1, D-83024 Rosenheim, Fax 08031/805-603, wolfgang.radlik@imaps.de

Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß § 4 Nr. 22 UstG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

Internet-Auftritt von IMAPS Deutschland

Sie finden die Webseiten von IMAPS Deutschland im Internet unter

http://www.imaps.de

Hier finden Sie aktuelle Informationen über Veranstaltungen und Ansprechpartner von *IMAPS Deutschland e.V.* Darüber hinaus können Sie dort auch Ihre Mitgliedschaft beantragen. Über Kritik und Anregungen, aber auch inhaltlichen Input würde sich der Vorstand sehr freuen.

Die internationalen Seiten von IMAPS erreichen Sie unter

http://www.imaps.org



Kontakte und Adressen des IMAPS-Vorstandes

Dr.-Ing. Jens Müller 1. Vorsitzender c/o ZiK MacroNano

ZMN – Außenstelle Haus M

Am Helmholtzring 1 98693 Ilmenau

Fon: 03677/69-3380 03677/69-3379 Fax:

e-mail: jens.mueller@imaps.de

Dr.-Ing. Gisela Dittmar

2. Vorsitzende

c/o Ingenieurbüro Elektroniktechnologie

Egerlandstraße 88 D-73431 Aalen

Fon: 07361/931129 Fax: 07361/943004

e-mail: gisela.dittmar@imaps.de

Prof. Dr. Wolfgang Radlik

Schatzmeister c/o FH Rosenheim Hochschulstraße 1 D-83024 Rosenheim Fon: 08031/805-629 Fax: 08031/805-603

e-mail: wolfgang.radlik@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Matthias Fischer

Schriftführer

c/o FH Schmalkalden FB Elektrotechnik D-98574 Schmalkalden Fon: 03683/688-5116

Fax: 03683/688-5499 e-mail: matthias.fischer@imaps.de

Dipl.-Phys. Rolf Aschenbrenner

Öffentlichkeitsarbeit

c/o Fraunhofer Institut Zuverlässigkeit und

Mikrointegration

Chip Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25

D-13355 Berlin

030/46403-164 Fon: 030/46403-161 Fax:

e-mail: rolf.aschenbrenner@imaps.de

Dipl.-Min. Franz Bechtold Öffentlichkeitsarbeit c/o VIA electronic GmbH

Robert-Friese Straße 3 D-07629 Hermsdorf Fon: 036601/81-529 Fax: 036601/81-530

e-mail: franz.bechtold@imaps.de

Dipl.-Ing. Paradiso Coskina Öffentlichkeitsarbeit

c/o VDI/VDE Innovation + Technik GmbH

Rheinstraße 10 B D-14513 Teltow

03328/435-242 Fon: 03328/435-256 Fax:

e-mail: paradiso.coskina@imaps.de

Dr.-Ing. Karl-Heinz Drüe Öffentlichkeitsarbeit c/o TU Ilmenau Fakultät EI

FG Mikroperipherik

Pf 100565 D-98684 Ilmenau 03677/69-3429 Fon:

Fax: 03677/69-3350

e-mail: karl-heinz.drue@imaps.de

Ernst Eggelaar Öffentlichkeitsarbeit

c/o Microtronic Microelectronic Vertriebs GmbH

Klein Grötzing

D-84494 Neumarkt-St. Veit Fon: 08722/9620-0 08722/9620-30 Fax:

e-mail: ernst.eggelaar@imaps.de

Prof. Dr.-Ing. Heinz Osterwinter

Öffentlichkeitsarbeit

c/o FHTE Standort Göppingen

Robert-Bosch-Str. 1 D-73037 Göppingen Fon: 07161/679-157 Fax: 07161/679-233

e-mail: heinz.osterwinter@imaps.de

Dr. Martin Oppermann Öffentlichkeitsarbeit EADS Deutschland GmbH

Microwave Factory / Defence Electronics

Woerthstr. 85 D-89077 Ulm

Fon: 0731/392-3879 Fax: 0731/392-3362

e-mail: martin.oppermann@imaps.de